

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **58052814 A**
 (43) Date of publication of application: **29.03.1983**

(51) Int. Cl. **H01L 21/02**

(21) Application number: **56150968**
 (22) Date of filing: **24.09.1981**

(71) Applicant: **NEC CORP**
 (72) Inventor: **UEJI YASUO**

(54) **SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT**

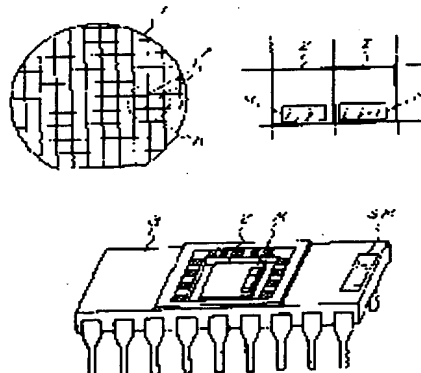
(57) Abstract:

PURPOSE: To permit the analysis of characteristic variations of a circuit in an assembly process to be easily and correctly carried out in relation to the circuit position in its wafer state, by a method wherein each chip obtained by cutting a wafer into each circuit piece is provided with a mark representing its arrangement order in the wafer state.

CONSTITUTION: Each of circuits 2, 2... in a wafer is provided with a mark M having a combination of (i) representing the lateral order and (j) representing the longitudinal order. Therefore, it is possible to identify the position of each chip in its wafer state even after cutting the wafer into chips. If the corresponding chip 2 is mounted on a case 3 previously provided with a mark 3M, in an assembly process, then it is possible to make an assembled circuit and the circuit in its wafer

state correspond to each other, one to one. Accordingly, various characteristics of a circuit in its wafer state and those of the circuit after being assembled can be made to correspond to each other.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio



⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑭ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—52814

⑮ Int. Cl.³
H 01 L 21/02

識別記号

庁内整理番号
6679—5F

⑯ 公開 昭和58年(1983)3月29日

発明の教 1
審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑰ 半導体集積回路

東京都港区芝五丁目33番1号E
本電気株式会社内

⑱ 特 願 昭56—150968
⑲ 出 願 昭56(1981)9月24日
⑳ 発 明 者 上路康雄

㉑ 出 願 人 日本電気株式会社
東京都港区芝5丁目33番1号
㉒ 代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

半導体集積回路

2. 特許請求の範囲

ウェーハ状態から各回路個片に切断されて得られたチップを含む半導体集積回路において、前記チップにはウェーハ状態での配列順番を授与す記号が付加されていることを特徴とする半導体集積回路。

3. 発明の詳細を説明

本発明は半導体集積回路に関する。

半導体集積回路の製造は、一般に第1図に示す

仕上りの工程を含む後工程と呼ばれる組立工程に分けられる。

前工程では、一枚のウェーハ上の多数個の回路が同時に処理されるが、後工程では一回路毎の個片に切断されて得られたチップ単位で処理されるこのため、ウェーハ状態での回路と、組立後の回路とを、一対一に対応づけが必要を場合、ウェーハの切断から組立完了迄、回路個片、すなわちチップの配列が変わらないように工夫をし、十分な管理が必要であった。そのように取扱っても、配列が狂った場合、正しい配列に戻すことは不可能であった。又、配列が狂った^かどうかの確認すら出来ない状態であった。

このように、ウェーハでの回路と、組立後の回路とを一対一に対応させることは著しく困難であ

特開昭59- 52814(2)

路個片に切断されて得られるチップにウェーハ状態での配列順序を表わす記号が付加されている。

つぎに本発明を実施例により説明する。

第2図では、ウェーハ上に回路2が多数製作されていることを示しており、点線で囲むAの部分拡大し、第3図に示す。

第3図に示す如く、本発明では、ウェーハでの各回路2、2、…の個々には、検行の順序を示す1、縦列の順序を示す1との組合せ(1, 1)をもつ記号Mが付加されているので、チップに切断後も、個々のチップのウェーハ状態の位置を識別することが出来る。

したがって、第4図の如く、組立工程であらかじめ記号3Mを付加したケース3に対応するチップ2を搭載すれば、組立後の回路とウェーハでの回路とは一対一に対応させることが可能である。

記号は一連番号であってもよいし、配列を表わす記号であれば数字でなくともよい。

以上説明したように、前工程と後工程の回路の対応が一対一で出来るため、ウェーハ状態での回

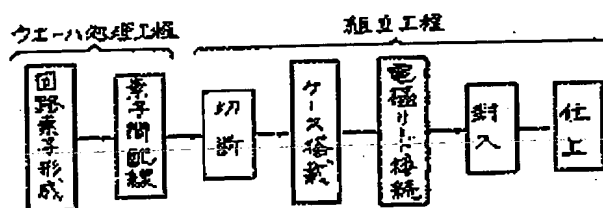
路の諸特性と、組立後の回路の諸特性に対応、即ち、組立工程での特性変動の解析がウェーハ状態での回路位置と関係づけて容易に、正しく行うことが可能になり、本発明の効果は著しいものがある。

4. 図面の簡単な説明

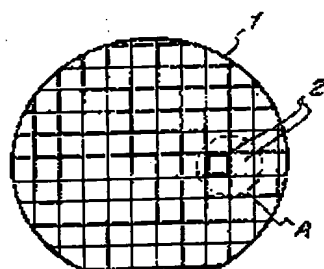
第1図は半導体集積回路の製造流れを示すフロー図、第2図は本発明の一実施例に係る多数個の回路が形成されたウェーハの平面図、第3図は第2図のA部分拡大図、第4図は本発明の一実施例の斜視図である。

1……半導体ウェーハ、2……チップ、M……チップの配列順序記号、3……ケース、3M……ケース記号。

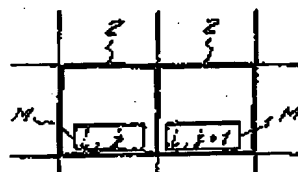
代理人 弁護士 内 原 晋



第1図



第2図



第3図

